

筑波科技推出 TZ6000 满足非破坏性检测市场需求

2023-03-13 筑波科技

位在竹北生医园区，以提供测试解决方案的领导和供货商，满足通讯组件、设备和系统制造商客户需求的筑波科技（ACE Solution），宣布推出 TZ6000，此系一种用于化合物半导体的非破坏性晶圆质量测量方案。结合 TeraView 的 TeraPulse Lx 技术，针对厚度、折射率、电阻率、介电常数、选定位置的表面/次表面缺陷和整个晶圆扫描达成非破坏性晶圆质量测量。

筑波科技研发副总陈治诚博士（JC Chen）表示，半导体晶圆的质量决定终端设备可达成的最大转换效率。晶圆表面加工过程包括粗磨、精磨和化学机械抛光，很容易引起次表面损伤（SSD）。目前仰赖 VIS/IR/UV 光学检测的晶圆检测系统虽可分析晶圆的表面特性，但因为穿透深度较低，不能分析 SSD。太赫兹（THz）针对半导体晶圆能比硅、碳化硅和氮化镓有更高的穿透深度。筑波以 THz 技术开发 TZ6000，满足化合物半导体晶圆非破坏性检测的市场需求。



TZ6000 System 结合 TeraPulse Lx ，应用于化合物半导体之非破坏性晶圆质量测试。左为筑波科技董事长许深福，右为 TeraView 首席科学家 Dr. Philip Taday。
(图 / 筑波科技提供)

ACE 筑波网络科技-电子量测方案供应商 ACE RF Integrated Solution Provider



筑波网络科技（苏州）有限公司
ACE Technology Corp.

中国: +86-15150183920 Ken 林总监
苏州: +86-512-89188620 吴小姐
深圳: +86-755-29351095 蔡小姐
台湾: +886-983139307 Peter 李经理

www.acesolution.com.cn / sales@acesolution.com.cn



TeraView 应用主席兼首席科学家 Philip F. Taday 博士强调, TeraPulse Lx 系统是 TeraView 世界领先的太赫兹分析系列, 能满足成像或光谱应用中材料检测的需求, 是化合物半导体产业的理想选择。该系统的模块化架构和 TeraView 专利研发之激光门控光电导发射器、检测器, 为使用者提供灵活性和可扩展性, 标准配置系统更具备领先的 3,200 ps 时间延时线。

筑波科技董事长许深福 (Steve Hsu) 分享, 本公司是电气精密测试、集成服务和解决方案的领先者, 与 TeraView 合作将本公司优势发挥在 TeraPulse Lx 模块整合到 TZ6000 系统, 以进行非破坏性晶圆质量检测。TZ6000 之高灵活性可适用各种尺寸和形状的晶圆, 配有筑波独特的多元晶圆探头及智能化软件演算分析功能, 用于同时测量晶圆表征的多个参数。TZ6000 具有用户易懂的图形说明软件, 用于晶圆制造和研发过程的质量检测。

TeraView 首席执行官 Don Arnone 博士总结, 此方案是 TeraView 与筑波科技密切合作开发的另一领先里程碑, 双方秉持高度信心将该产品用于化合物半导体晶圆质量分析和缺陷检测。TeraPulse Lx 系统有一轻巧紧密的核心单元设计, 易于不同地点运输。结合 TeraView 的 TeraPulse Lx 模块, 可透过此产品满足化合物半导体晶圆产业大幅成长的需求。

ACE 筑波网络科技-电子量测方案供应商 ACE RF Integrated Solution Provider



筑波网络科技 (苏州) 有限公司
ACE Technology Corp.

中国: +86-15150183920 Ken 林总监
苏州: +86-512-89188620 吴小姐
深圳: +86-755-29351095 蔡小姐
台湾: +886-983139307 Peter 李经理

www.acesolution.com.cn / sales@acesolution.com.cn

